

## 上海万业企业股份有限公司 对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、对外投资事项概述

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日与中国科学院微电子研究所（以下简称“中科院微电子所”）、芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）签订《关于合资设立集成电路装备集团之合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》”）。公司与中科院微电子所拟共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公司（以下简称“装备集团”），项目总投资 15 亿元，其中，中科院微电子所与万业企业共同出资 8 亿元，芯鑫租赁拟为装备集团提供意向性融资额度 5 亿元，具体以决策审批结果为准。本《合作备忘录》签署后，各方制定人员组成筹备组，并选举筹备组组长、副组长；筹备组负责选择装备集团落户地以及装备集团设立其他前期工作，在 2019 年 12 月 30 日前完成筹备工作。详情参见公司于 2019 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于签订合资设立集成电路装备集团合作备忘录的公告》（公告编号：临 2019-036）。

### 二、本次对外投资进展

在《合作备忘录》签署后，公司就合作事宜积极开展装备集团的前期准备工作，与意向方开展了调研工作，进行了多次洽谈。由于客观原因，截至 2019 年 12 月 30 日，各方未就装备集团具体的合作方案细节达成一致意见，亦未签署正式法律文件。公司决定在谈判中把维护公司利益、防范可能的风险放在首要位置，因此，装备集团的前期筹备工作不得不延期。

### 三、对公司的影响

截止本公告日，公司尚未投入资金。装备集团筹备工作的延期不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，积极推动公司向集成电路产业的战略转型。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日